



NDST-SPT-500

导热硅脂



产品描述

NDST-SPT-500是一种具有超低热阻、易铺展特性，应用于高功率器件，如CPU，GPU，ASICs，北桥以及发热器件间。其优良的表面浸润性能，适用于丝网印刷方式较薄地涂覆于发热或散热器件间。同时，该款导热硅脂可通过各种工业可靠性测试，并可满足多种应用领域的使用要求。

特性与优点

- 高导热性能
- 低界面热阻
- 优异的可靠性

典型应用

- 手机数码设备
- 个人电脑、服务器
- 智能硬件设备

典型属性

属性	典型值	测试方法
颜色	白色、灰色、粉色、蓝色	目视
导热系数(W/m.K)	5.0	HOT DISK
热阻 ($^{\circ}\text{C}\cdot\text{cm}^2/\text{W}$)	0.14	ASTM D5470, 40PSI@80 $^{\circ}\text{C}$
渗油率 (%)	≤ 1	评估导热材料在125 $^{\circ}\text{C}$ 、7D的质量减少
最小施工厚度 (μm)	≤ 35	-
绝缘性 (Q.cm)	10^{12}	IPC-TM-650 2.6.3.7, 85 $^{\circ}\text{C}$ /85%RH 下监控绝缘电阻
密度 (g/cm^3)	2.9 ± 0.1	ASTM D792
离子含量 (pm)	F-,Cl-,Br-等卤素离子 总含量 < 20p	MIL-STD-883 Method5011.4
热阻可靠性	符合	温循 (-40-125 $^{\circ}\text{C}$) 1000cycles、高温 125 $^{\circ}\text{C}$ 1000h 后， 无变粉、pump out、dry out 等失效现象。 热阻值增加 $\leq 15\%$
环保要求	符合	RoHS2.0
阻燃性	V-0	UL94
保质期(月)	6个月	温度 < 40 $^{\circ}\text{C}$ ，避免挤压、暴晒